

SHL-SMT 5.00/03GR 1.5RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



高耐熱性、直線、開いたピンヘッダー。箱もしくはテープ梱包。1.5 mm の溶剤ピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびウェーブはんだ付け適合3.2 mm 溶剤ピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

バージョン	プリント基板用プラグインコネクタ、接続要素、右、オス型ヘッダー、開側、THT/THRはんだ接続、5.00 mm、極数: 3、90°、溶剤ピン長 (l): 1.5 mm、錫メッキ、黒色、Tape
注文番号	1063170000
種別	SHL-SMT 5.00/03GR 1.5RL
GTIN (EAN)	4032248814848
数量	175 Stück
製品データ	IEC: 400 V UL: 300 V / 9 A / AWG 26 - AWG 12
パッケージ	Tape

作成日 2024/11/05 19:54:12 CET

SHL-SMT 5.00/03GR 1.5RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	23.3 mm	奥行き (インチ)	0.917 inch
高さ	14.4 mm	高さ (インチ)	0.567 inch
下位バージョンの高さ	11.2 mm	幅	15.4 mm
幅 (インチ)	0.606 inch	長さ	23.3 mm
長さ (インチ)	0.917 inch	正味重量	4.337 g

システムパラメータ

製品ファミリー	OMNIMATEハウジング - シリーズCH20M	接続方式	基板接続
ピッチ (mm) (P)	5 mm	ピッチ (インチ) (P)	0.197 "
極数	3	L1 (mm)	10 mm
L1 (インチ)	0.394 "	行数	1
ピンモデルシリーズ数量	1	保護度合い	IP20
体積抵抗	≤5 mΩ	コーディング可能	はい


材料データ

絶縁材	LCP	色	黒色
カラーチャート (類似)	RAL 9011	絶縁材グループ	IIIa
比較追跡指数 (CTI)	175 ≤ CTI < 400	Moisture Level (MSL)	1
UL 94 可燃性等級	V-0	接点材質	銅合金
接触表面	錫メッキ	保管温度、最小	-40 °C
保管温度、最大	70 °C	動作温度、最小	-40 °C
動作温度、最大	120 °C	温度範囲、設置、最小	-30 °C
温度範囲、設置、最大	120 °C		

IEC規格に準拠した公称データ

標準に準拠して検査済	IEC 60664-1, IEC 61984	定格電流、最大極数 (Tu=20°C)	10 A
定格電流、最大極数 (Tu=40°C)	9 A	サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2	400 V
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2	320 V	サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3	250 V
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 II/2	4 kV	サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/2	4 kV
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/3	4 kV		

CSAに準拠した公称データ

試験制度 (CSA)		証明書番号 (CSA)	200039-70153051
定格電圧 (グループ B/CSA 使用)	300 V	定格電圧 (グループ C / CSA 使用)	50 V
定格電圧 (グループ D/CSA 使用)	300 V	定格電流 (グループ B/CSA 使用)	9 A
定格電流 (グループ C / CSA 使用)	9 A	定格電流 (グループ D/CSA 使用)	9 A
導体断面積、AGW、最小	AWG 26	導体断面積、AWG、最大	AWG 12
認可値の参照	仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。		

SHL-SMT 5.00/03GR 1.5RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

UL 1059に準拠した公称データ

設定 (cURus)



証明書番号 (cURus)

E60693

定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用) 300 V

定格電圧 (C/UL 1059 グループ使用) 50 V

定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用) 300 V

定格電流 (グループ B / UL 1059 使用) 9 A

定格電圧 (使用グループ C/UL 1059) 9 A

定格電流 (グループ D / UL 1059 使用) 9 A

導体断面積、AGW、最小

AWG 26

導体断面積、AWG、最大

AWG 12

承認値への参照

仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。

材質データ

UL 94 可燃性等級

V-0

比較追跡指数 (CTI)

175 ≤ CTI < 400

絶縁材

LCP

絶縁材グループ

IIIa

一般データ

カラーチャート (類似)

RAL 9011

保護度合い

IP20

封止オプション

いいえ

色

黒色

分類

ETIM 6.0

EC002637

ETIM 7.0

EC002637

ETIM 8.0

EC002637

ETIM 9.0

EC002637

ECLASS 9.0

27-44-04-02

ECLASS 9.1

27-44-04-02

ECLASS 10.0

27-44-04-02

ECLASS 11.0

27-46-02-01

ECLASS 12.0

27-46-02-01

ECLASS 13.0

27-46-02-01

ECLASS 14.0

27-46-02-01

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

No SVHC above 0.1 wt%

重要なメモ

IPC準拠

適合性：製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。

承認

認可



ROHS

適合

UL File Number Search

UL ウェブサイト

証明書番号 (cURus)

E60693

作成日 2024/11/05 19:54:12 CET

SHL-SMT 5.00/03GR 1.5RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	CSA Certificate of Compliance
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP CAD data – Design IN construction drawings 5.0 CAD data – Design IN PCB layout 5.0 CAD data – PCB_position_70149_LP-POSITION_17MM CAD data – Pin_header_pin_length_CH20M_A_OV_PCB-SHL_70315
ユーザ文書	Through-Hole-Reflow Design Anwendungsempfehlung Through-Hole-Reflow design recommendation for use
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN PO OMNIMATE EN

SHL-SMT 5.00/03GR 1.5RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

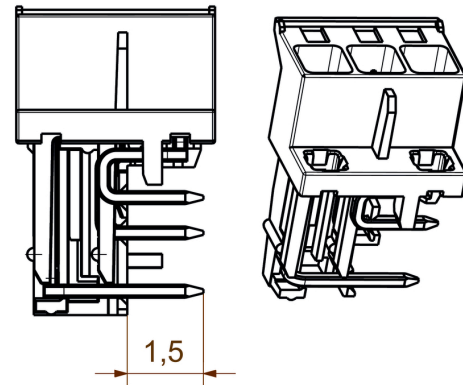
www.weidmueller.com

図面

使用例



寸法図



使用例



delivery

使用例



delivery

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.

Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.